

Die Anmeldung erfolgt über **ConfTool**:
www.conftool.net/imaps-herbstkonferenz-2025

Für den Nachweis der Mitgliedschaft bei IMAPS-Deutschland tragen Sie bitte Ihre Mitgliedsnummer in das Registrierungsformular ein.

TEILNAHMEGEBÜHREN:

- € 230,- IMAPS-Mitglieder
- € 325,- Nichtmitglieder
- € 90,- Vortragende
- € 40,- Studierende

Die Bezahlung der Teilnahmegebühr erfolgt gegen Rechnung.

In der Teilnahmegebühr sind die Tagungsunterlagen, der Pausenkaffee und die Teilnahme an der Abendveranstaltung im Augustiner enthalten. Die Gebühren sind gemäß § 4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei.

Bitte melden Sie sich über unsere Internetseite an!

www.imaps.de



WEITERE VERANSTALTUNGEN:

EMPC 2025 – 25th European Microelectronics Packaging Conference, 16.–18. September 2025, World Trade Center, Grenoble (France) | <https://www.empc2025.org>

IMAPS Symposium 2025, 29. September – 2. Oktober 2025, San Diego (USA) | <https://imaps.org>



Begleitende Ausstellung

Stand ca. 6 m². Mögliche Ausstattung (bitte mit Anmeldung übermitteln):

- **Tisch** (ca. 120x80 cm) und 2 Stühle
- **Pinwand** (ca. 120x120 cm)
- **230 V-Anschluss**

PREIS: € 980,-

Der Preis beinhaltet neben dem Stand auch die Teilnahme an der Konferenz und der Abendveranstaltung für 2 Personen.

ANMELDUNG

Sie können sich nur über unsere Internetseite als Aussteller registrieren.

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Anmeldungen zur Ausstellung werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt!

ANREISE MIT DER BAHN U. ÖPNV

Von München Hauptbahnhof fahren Sie mit den Tramlinien 20 (Moosach Bf.), 21 (Westfriedhof) oder 29 (Hochschule München) bis zur Haltestelle „Hochschule München (Lothstraße)“.



INFORMATIONEN + RESERVIERUNG FÜR AUSSTELLUNG:

Ernst Eggelaar, MBA
 Tel.: +49 8722/9620-0
 E-Mail: ee@imaps.de



Deutsche IMAPS-Konferenz 2025

Herbstkonferenz
 16.–17.10.2025

Hochschule München
 Munich University of Applied Sciences
 Lothstr. 64
 D-80335 München

AB 08:00 UHR EINSCHREIBUNG UND GET-TOGETHER (GALERIE)**09:00 – ERÖFFNUNG UND BEGRÜßUNG**

09:10 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM / IMAPS*

09:10 – ULTRASCHALLBONDEN UND -LÖTEN

10:25 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM / IMAPS*

09:10 Modellgestützte Optimierung eines Ultraschall-Torsionsschweißsystems

Markus Dohmen¹, Peter Bornmann², Walter Littmann², Tobias Hemsel¹, Walter Sextro¹,
1: Universität Paderborn; 2: Athena Technologie Beratung GmbH

09:35 Influence of Different Control Strategies on the Heavy Wire Bonding Quality

Bernhard Rebhan, Josef Sedlmair, *F&S Bondtec Semiconductor GmbH*

10:00 Neue flussmittelfreie Lotpastensysteme für waschfreie Lötprozesse

Andreas Karch, *Indium Corporation*

10:25 – VORSTELLUNG DER AUSSTELLER

10:45 Ort: Hörsaal
Chair: Matthias Lorenz, *AEMtec*

10:45 – PAUSE UND AUSSTELLUNG

11:30 Ort: Galerie

11:30 – KERAMIKSUBSTRATE

12:45 Ort: Hörsaal
Chair: Jens Müller, *TU Ilmenau / IMAPS*

11:30 Integration of Functional Materials in Ceramic Multilayer Technology: ZnO-based Varistor Screen**Printing Paste Development**

Arno Görne¹, Tina Block¹, Qaisar Khushi Muhammad², Uwe Krieger², *1: Fraunhofer IKTS; 2: VIA electronic*

11:55 Machbarkeitsstudie über in Silizium eingesinterte LTCC-Einsätze zur Erweiterung der Substratfunktionalität

Michael Fischer, Cathleen Kleinholz, Alexander Schulz, Björn Müller, Jens Müller, *TU Ilmenau*

12:20 Kontaktthermografie und Multi-Energie-Röntgendiagnostik als zerstörungsfreie Prüfverfahren für gelötete Halbleiter-Dies auf DCB-Substraten

Martin Oppermann, Oliver Albrecht, Thomas Zerna
TU Dresden

12:45 – PAUSE UND AUSSTELLUNG

13:45 Ort: Galerie

13:45 – SIMULATION UND MODELLIERUNG

15:00 Ort: Hörsaal
Chair: Indira Käßlinger, *CIS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH / IMAPS*

13:45 Generic Transient Thermal FE Based Digital Twin for Automotive High Power LEDs to Predict Solder Joint Reliability

Gokulnath Vellaisamy Muniyandi, Hannes Schwan, Gordon Elger, *Technische Hochschule Ingolstadt*

14:10 AI Driven Model for Optimizing Active Metal Brazed (AMB) Ceramic Substrates Reliability

Abdel Rahman Alkasabreh, Gordon Elger, *Technische Hochschule Ingolstadt*

14:35 Simulation der mechanischen Beanspruchungen in MLCC-Komponenten durch thermische Gradienten bei Entlötprozessen zum Zweck von Reparatur oder Wiederverwendung

Steffen Wiese, *Universität des Saarlandes*

15:00 – PAUSE UND AUSSTELLUNG

15:35 Ort: Galerie

15:35 – POLYMERE IN DER MIKROSYSTEMTECHNIK

16:50 Ort: Hörsaal
Chair: Matthias Lorenz, *AEMtec*

15:35 Influence of Total Encapsulation of White-light Mid-power LED Packages over the Correlated Colour Temperature

Edward Olivera, Matthias Hien, Mahmoud Beker, Markus Zankl, *THD Technologie Campus Cham*

16:00 Advancing Sustainability of Printed Circuit Board Manufacturing for Next-generation Green Electronics

Nihesh Mohan¹, Pratheep Kumar Annamalai², Gordon Elger¹, *1: Technische Hochschule Ingolstadt, 2: University of Southern Queensland*

16:25 Innovative Aufbaukonzepte von MEMS-IR-Emittern

Toni Schildhauer, Michael Hintz, Manuel Kermann, Christian Maier, Andreas Winzer, *CIS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH*

17:00 – IMAPS-MITGLIEDERVERSAMMLUNG

18:00 Ort: Hörsaal
Chairs: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM/IMAPS*

AB GEMEINSAMES ABENDESSEN IN DEN

19:30 AUGUSTINER GASTSTÄTTEN
Neuhauser Str. 27, 1. OG, Grüner Saal

Freitag, 17.10.2025

09:00 – ENABLING TECHNOLOGIES I

10:40 Ort: Hörsaal
Chair: Artem Ivanov, *University of Applied Sciences Landshut*

09:00 Fabrication and Characterization of Nanoporous Copper Structures for Contacting Applications in Wafer Level Packaging

Jordis Take¹, Markus Wöhrmann¹, Morten Brink¹, Martin Schneider-Ramelow², *1: Fraunhofer IZM, 2: TU Berlin*

09:25 Fortschritte beim mmW-Packaging über 100 GHz: Integration aktiver Module mittels UPD-Druck und neuartigem Leveling-Konzept

Janis Blank, Thomas Zwick, *KIT*

09:50 Thermal Laser Processes in Printed Electronics: Sustainable and Rapid Post-processing for High Volume Production

Alexander Görk, *Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH*

10:15 Aufbau- und Verbindungstechnik eines 800 V Hochstrom-Leistungsmoduls mit TO-263 SiC MOSFETs auf Metallkernleiterplatte

Bernhard Jahn, Alexander Kleimaier, *Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut*

10:40 – PAUSE UND AUSSTELLUNG

11:30 Ort: Galerie

11:30 – ENABLING TECHNOLOGIES II

13:10 Ort: Hörsaal
Chair: Alexander Hensel, *Siemens AG*

11:30 Condition Monitoring Powered AI for Repair and Reuse in Electronics

Andreas Zippelius, *Technische Hochschule Ingolstadt*

11:55 Flexible Codierung von Chip-Less RFID-Tags im Fertigungsprozess durch Laserdirektbelichtung von photostrukturierbaren Dickschichtpasten

Peter Uhlig¹, Lynn Möhring², Enrico Tolin¹, Martin Ihle², Birgit Manhica², *1: IMST GmbH; 2: Fraunhofer IKTS*

12:20 Hochfrequenzstörepfindlichkeit von mikromechanischen Mikrofonen

Margarita Chizh, *Hochschule München*

12:45 Power Electronics Packaging – New Perspectives with Compression Molding

Marcus Voitell, *TU Berlin*

13:10 – SCHLUSSWORT DES IMAPS-VORSITZENDEN

13:15 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM/IMAPS*